



Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung 2011

Haus der Bayerischen Wirtschaft
21. Juni 2011

Disclaimer

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge der SÜSS MicroTec AG oder ihrer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen und unterliegen daher Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der SÜSS MicroTec AG liegen. Die SÜSS MicroTec AG übernimmt deshalb keine Gewähr dafür, dass die Erwartungen und Ziele, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden, erreicht werden. Die SÜSS MicroTec AG beabsichtigt auch nicht und übernimmt keine Verpflichtung, eine Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen.

Agenda

- I. Überblick
- II. Strategische Restrukturierung
- III. Das Geschäftsjahr 2010 in Zahlen und Q1 2011 in Zahlen
- IV. Die Aktie
- V. Produkte und Märkte
- VI. Ausblick

SÜSS MicroTec auf einen Blick

- + SÜSS MicroTec ist einer der weltweiten Marktführer in der Mikrostrukturierung
- + Unser Equipment und unsere Prozesslösungen schaffen die Mikro- und Verbindungsstrukturen der Mikroelektronik
- + Unser Fokus richtet sich auf die wachstumsstarken Marktsegmente: Advanced Packaging/3D-Integration, MEMS, LEDs



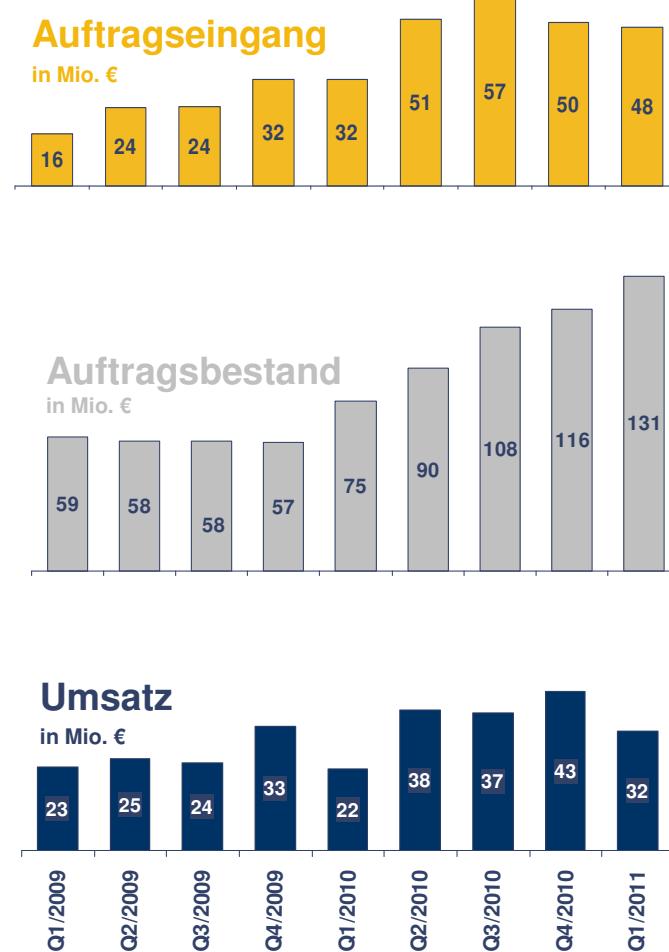
Kennzahlen zur Aktie:

- + Bloomberg Symbol: SMH
- + Mitglied im TecDax
- + Aktienkurs am 31.05.2011: 10,76 €
- + Marktkapitalisierung: 200 Mio. €
- + Net Cash: 35 Mio. €



Meilensteine 2010

- ⊕ Kräftiger Aufschwung nach der Wirtschaftskrise
 - ⊕ Auftragseingang + 97% auf 189,3 Mio. €
 - ⊕ Drei starke aufeinanderfolgenden Quartale im Auftragseingang
 - ⊕ Umsatz + 34% auf 139,1 Mio. €
 - ⊕ EBIT Marge >10% vom Umsatz
 - ⊕ Umfangreiche Restrukturierung der Gruppe
 - ⊕ Kapitalerhöhung im Mai 2010
 - ⊕ Solide Liquiditätsposition



Produktspezifische Meilensteine 2010

- + **Marktführerschaft in drei von vier Produktbereichen durch innovative Produkte**
 - MA100e Gen2 erringt Marktführerschaft in der LED Belichtung
 - ASC300 Gen2 ist das bevorzugte Coater/Developer Cluster für Advanced Packaging Applikationen
 - XBC 300 ist die einzige Bonder-Produktions-Anlage die eine Vielzahl von temporären Bond/Debond-Prozessen für 3D-Integration unterstützt
 - Mask-Track-Pro unterstützt als weltweit einzige Maskenreinigungsanlage alle Lithografie-Technologien



XBC 300 Substrat Bonder



Mask- Track-Pro Maskenreinigungsgerät

Agenda

- I. Überblick
- II. Strategische Restrukturierung
- III. Das Geschäftsjahr 2010 in Zahlen und Q1 2011 in Zahlen
- IV. Die Aktie
- V. Produkte und Märkte
- VI. Ausblick

Restrukturierungsmaßnahmen in 2010

- ⊕ Im Laufe des Geschäftsjahres 2010 wurde ein umfangreiches Paket an Restrukturierungsmaßnahmen durchgeführt:
 - Fokussierung der Produktlinien
 - Konsolidierung der Produktionsstandorte
 - Anpassung der Struktur der internationalen Vertriebs- und Serviceorganisationen an zukünftige Anforderungen der Märkte
- ⊕ Alle Restrukturierungsmaßnahmen wurden erfolgreich abgeschlossen
- ⊕ Heute hat SÜSS MicroTec eine schlanke, kosteneffiziente und schlagkräftige Struktur, um die Schlüsselstellung in Wachstumsmärkten nachhaltig auszubauen

Fokussierung der Produktlinien

- ⊕ Fokussierung von SÜSS MicroTec auf
 - Kernkompetenzen: **Nassprozesse, Belichtung, Bonden**
 - Zielmärkte: **Mikrochips, MEMS, LED**
- ⊕ Erwerb der HamaTech APE
 - Erweiterung der Produktlinien um „Fotomasken Equipment“
 - Synergetische Ergänzung zu den Bereichen „Coater/Developer“ und „Temporäres Bonden“
- ⊕ Erwerb des Standortes Sternenfels
 - Hochmoderner Standort für die Volumenfertigung
- ⊕ Verkauf der Test-Systems-Division
 - Bereinigung des Produktportfolios um den verlustbringenden „Prober“-Bereich

Konsolidierung der Produktionsstandorte

- + Reduzierung der Produktionsstandorte von vier auf zwei
- + Ausbau von Sternenfels zum Hauptproduktionsstandort der Gruppe
 - Zusammenlegung der Fertigungsstandorte Vaihingen und Sternenfels
 - Verlagerung der Substrat Bonder- Aktivitäten von Waterbury, USA, nach Sternenfels

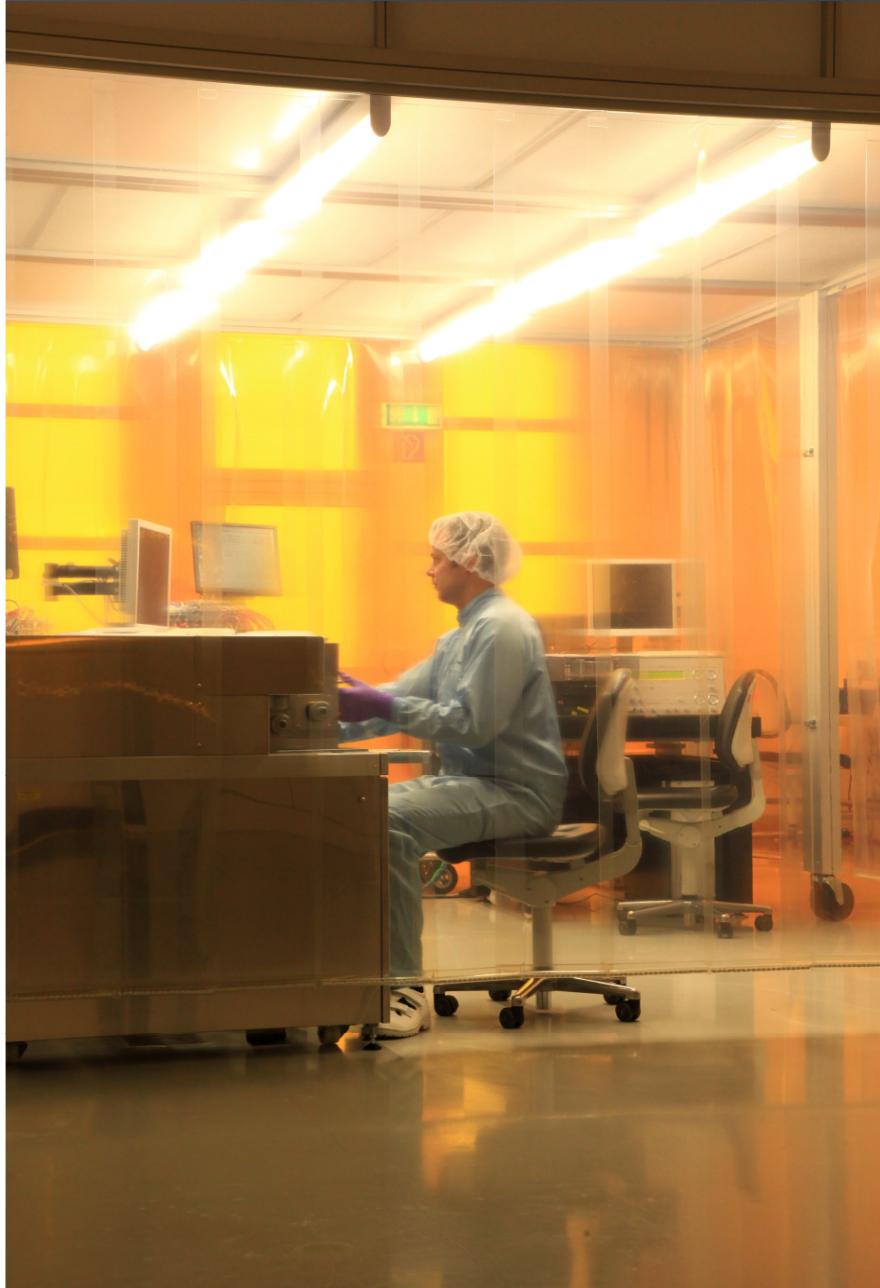


Sternenfels - Standort mit Potenzial

- + Drei Produktlinien unter einem Dach
- + Synergien in Entwicklung, Beschaffung und Fertigung
- + Reduzierung von Komplexität und Kosten; Schaffung flexibler Produktionsstrukturen



Sternenfels – auf einen Blick



- ⊕ Entwicklungszentrum
 - Technologieentwicklung
 - Produktentwicklung
 - Applikationsentwicklung
- ⊕ Volumenfertigung in zwei Produktionsreinräumen
- ⊕ Customer Care Center
- ⊕ Supply Chain Management

- ⊕ 15.000 m² Nutzfläche
- ⊕ 34.000 m² Grund und Boden
- ⊕ 270 Mitarbeiter

Internationale Vertriebs- und Servicestruktur

- + Schließung des Büros in Bangkok
- + Optimierung der Struktur Japan
- + Weiterer Aufbau in China
- + Aufstockung von Vertrieb und Service in Taiwan
- + Ausbau des Service-Stützpunktes Singapur für „Restliches Asien“
- + Neues Büro in DongTan, Korea
- + Verlagerung der US Vertriebs- und Serviceorganisation nach Sunnyvale im Silicon Valley



Die Restrukturierungsmaßnahmen in Zahlen

Erwerb der HamaTech

Kaufpreis Grundstück und Gebäude: 4,4 Mio. €
Kaufpreis HamaTech: 3,8 Mio. €
Earnout Zahlung in 2011: 300.000 €

Verkauf der Test Systeme

Mittelzufluss in 2010: 3,3 Mio. €
Mittelzufluss in 2011: 3,3 Mio. € (aus Cascade-Aktien)
weiterer möglicher Mittelzufluss bis 01/2012: 1,5 Mio. €

Transfer Substrat Bonder

Aufwand in 2010: 3,9 Mio. €
Aufwand in Q1 2011: 1,1 Mio. €
weiterer Aufwand in 2011: ~1,0 Mio. €

Strukturen optimieren - Zukunft gestalten



Garching

- + Sitz der SÜSS MicroTec AG
- + Entwicklung und Produktion:
 - **Mask Aligner**
 - **Bond Aligner**
- + Kernkompetenz:
 - **Belichtung**
 - **Positionierung**



Sternenfels

- + Entwicklung und Produktion:
 - **Bonder**
 - **Coater und Developer**
 - **Fotomasken Equipment**
- + Kernkompetenz:
 - **Nassprozesse**
 - **Waferbonden**

Agenda

- I. Überblick
- II. Strategische Restrukturierung
- III. Das Geschäftsjahr 2010 und Q1 2011 in Zahlen
- IV. Die Aktie
- V. Produkte und Märkte
- VI. Ausblick

Wesentliche Kennzahlen 2010

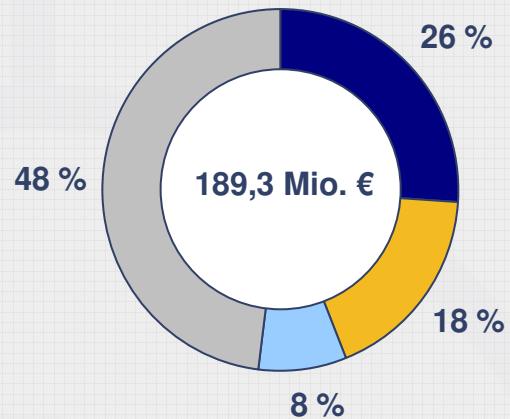
fortgeführte Aktivitäten

in Mio. €	2010	2009	in %	
Auftragseingang	189,3	96,3	97%	
Auftragsbestand zum 31.12.	116,1	57,0	104%	
Umsatz	139,1	103,9	34%	
EBIT	14,3	2,8	> 250 %	
<i>EBIT in % vom Umsatz</i>	<i>10,3%</i>	<i>2,7%</i>		
EBIT (bereinigt)	14,0	2,8	> 250 %	
<i>EBIT (bereinigt) in % vom Umsatz</i>	<i>10,1%</i>	<i>2,7%</i>		
Ergebnis nach Steuern	13,0	0,5	> 250 %	
EPS in € (unverwässert)	0,71	0,03	> 250 %	
Mitarbeiter zum 31.12.	616	498	24%	

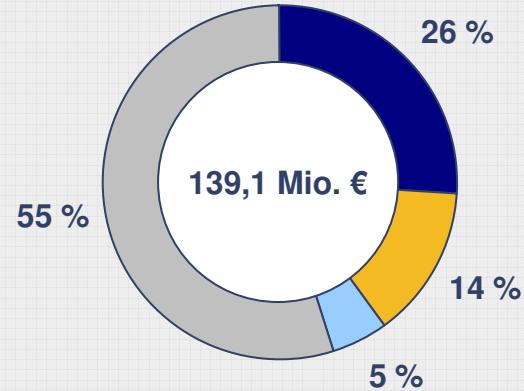
Auftragseingang und Umsatz nach Regionen 2010

fortgeführte Aktivitäten

Auftragseingang



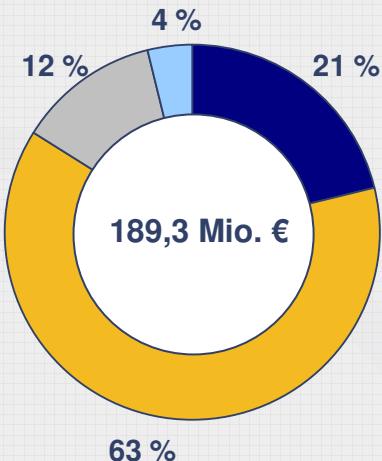
Umsatz



Auftragseingang und Umsatz nach Segmenten 2010

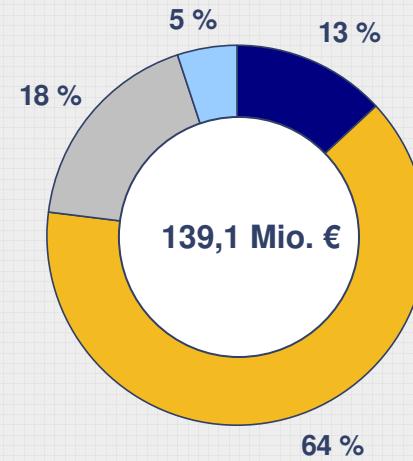
fortgeführte Aktivitäten

Auftragseingang



■ Fotomasken Equipment	39,0 Mio. €
■ Lithografie	118,9 Mio. €
■ Substrat Bonder	23,6 Mio. €
■ Sonstige	7,8 Mio. €

Umsatz



■ Fotomasken Equipment	18,4 Mio. €
■ Lithografie	88,9 Mio. €
■ Substrat Bonder	24,7 Mio. €
■ Sonstige	7,0 Mio. €

Kapitalflussrechnung 2010

fortgeführte Aktivitäten

in Mio. €	2010	2009
Gewinn (nach Steuern)	13,0	0,5
Cash Flow		
aus betrieblicher Tätigkeit	16,1	12,0
Cash Flow		
aus der Investitionstätigkeit	-10,6	-9,8
Free Cash Flow*	14,1	8,9
Cash Flow		
aus der Finanzierungstätigkeit	9,4	-2,1
Zahlungsmittel und –äquivalente		
zum Ende der Periode	36,5	20,8
Net Cash**	34,6	18,4

* vor Berücksichtigung von Erwerb verzinslicher Wertpapiere und M&A - Aktivitäten

** inkl. Bestand an verzinslichen Wertpapieren

Wesentliche Kennzahlen Q1 2011

fortgeführte Aktivitäten

in Mio. €	Q1 2011	Q1 2010	in %	
Auftragseingang	48,3	32,3	50%	
Auftragsbestand zum 31.03.	130,5	75,4	73%	
Umsatz	32,0	21,9	46%	
EBIT	2,5	-0,1	> 250%	
<i>EBIT in % vom Umsatz</i>	<i>7,8%</i>	<i>-0,2%</i>	<i>--</i>	
EBIT (bereinigt)	3,5	-1,5	> 250%	
<i>EBIT (bereinigt) in % vom Umsatz</i>	<i>10,8%</i>	<i>-6,8%</i>	<i>--</i>	
Ergebnis nach Steuern	2,4	-0,7	> 250%	
EPS in € (unverwässert)	0,13	-0,04	> 250%	
Mitarbeiter zum 31.03.	647	579	12%	

Kapitalflussrechnung Q1 2011

fortgeführte Aktivitäten

in Mio. €	Q1 2011	Q1 2010
Gewinn (nach Steuern)	2,4	-1,1
Cash Flow		
aus betrieblicher Tätigkeit	-1,0	-1,4
Cash Flow		
aus der Investitionstätigkeit	-17,0	-5,7
Free Cash Flow*	-2,2	-1,3
Cash Flow		
aus der Finanzierungstätigkeit	-0,2	-1,0
Zahlungsmittel und –äquivalente		
zum Ende der Periode	17,9	13,2
Net Cash**	35,1	11,0

* vor Berücksichtigung von Erwerb verzinslicher Wertpapiere und M&A-Aktivitäten

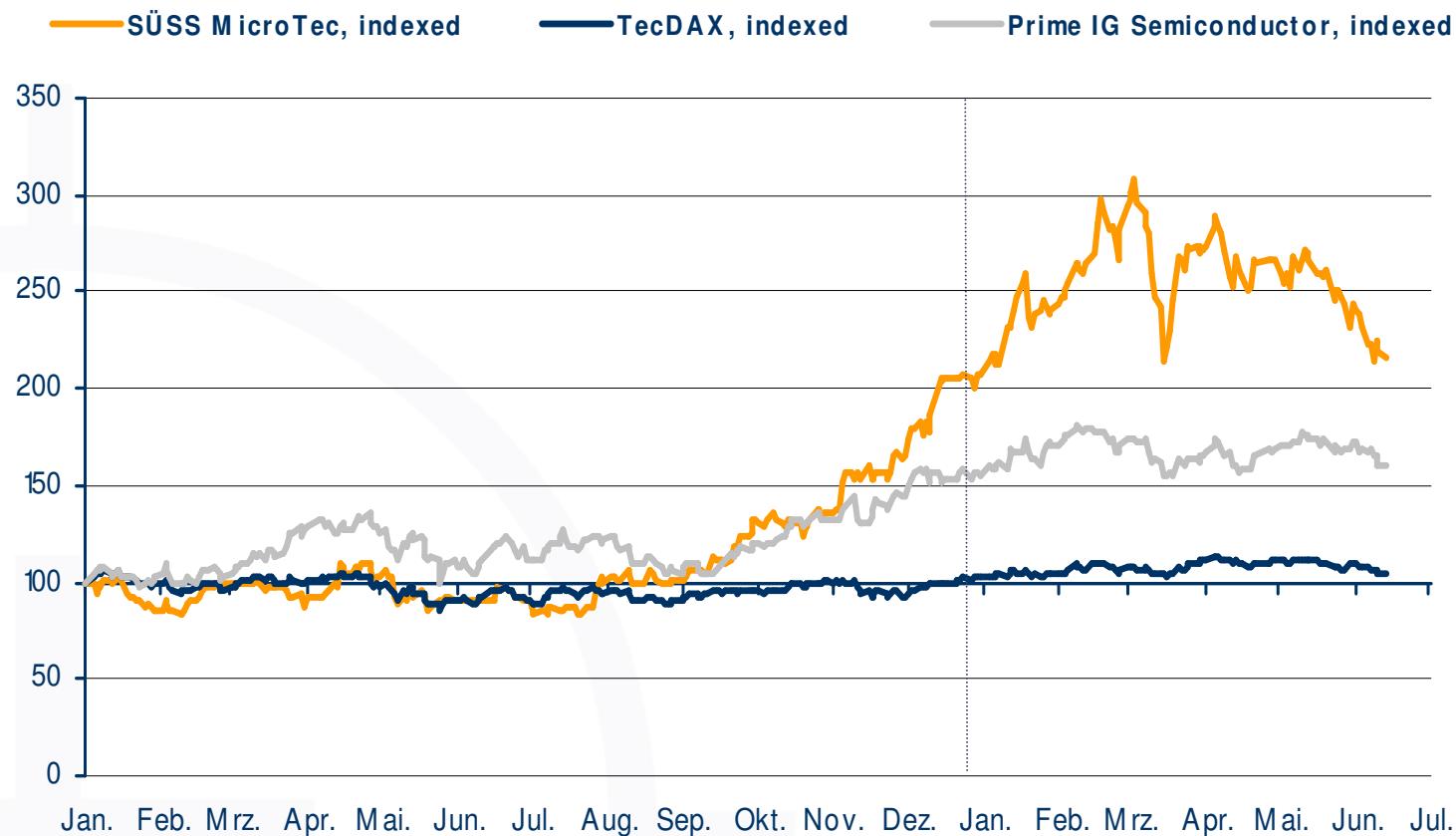
** inkl. Bestand an verzinslichen Wertpapieren

Agenda

- I. Überblick
- II. Strategische Restrukturierung
- III. Das Geschäftsjahr 2010 in Zahlen und Q1 2011 in Zahlen
- IV. Die Aktie
- V. Produkte und Märkte
- VI. Ausblick

Entwicklung der SÜSS MicroTec - Aktie

(Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie am 4. Januar 2010: € 4,40)

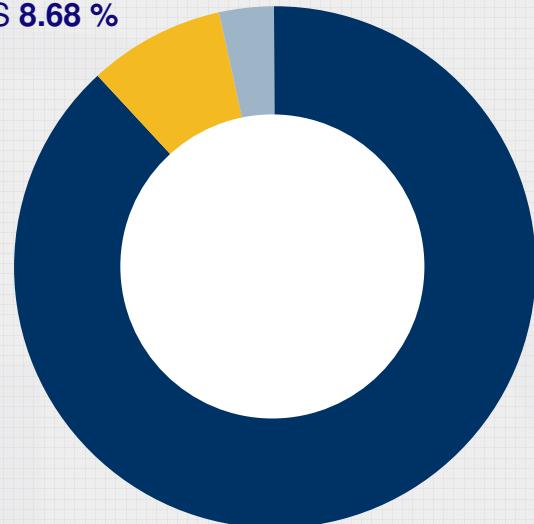


Eckdaten zur SÜSS MicroTec - Aktie

Aktionärsstruktur

Credit Suisse **3.35 %**

DWS **8.68 %**



Sonstige **87.97 %**

Kursentwicklung / Börsenumsatz

+ Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz:

- 2009: 46 tsd.
- 2010: 120 tsd.
- 2011: 275 tsd.

+ Eckdaten Kursentwicklung 2010:

- Jahreshöchstkurs: 9,14 €
- Jahrestiefstkurs: 3,71 €
- Jahresschlusskurs: 9,14 €

- Jahreshöchstkurs in 2011: 13,57 €

+ Analystencoverage von 4 auf 6 erhöht

Analystenbewertung

- + Sechs Banken berichten regelmäßig über SÜSS MicroTec
- + Fünf von sechs Analysten haben eine Kaufempfehlung ausgesprochen
- + Kursziele liegen zwischen 12,00 € und 18,50 € (ø Kursziel: 14,75 €)

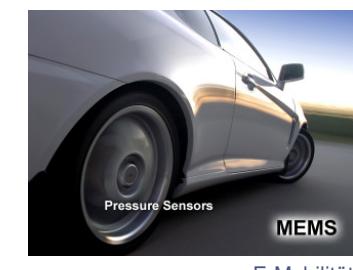
Close Brothers Seydler	Kaufen	13,00 €
DZ Bank	Kaufen	15,00 €
Equinet Bank	Halten	13,00 €
GBC Research	Kaufen	12,00 €
Hauck & Aufhäuser	Kaufen	18,50 €
SES Warburg	Kaufen	17,00 €

Agenda

- I. Überblick
- II. Strategische Restrukturierung
- III. Das Geschäftsjahr 2010 in Zahlen und Q1 2011 in Zahlen
- IV. Die Aktie
- V. Produkte und Märkte
- VI. Ausblick

Focus auf Wachstumsmärkte

- + Megatrends prägen die Mikroelektronik und sorgen für ein nachhaltiges Wachstum:
 - **Digitaler Lifestyle**
 - **E-Mobilität**
 - **Energieeffizienz**
- + Mikrochips, MEMS und LEDs sind die Bausteine für den technologischen Produktfortschritt
- + SÜSS MicroTec fokussiert sich mit Lösungen für die Entwicklung und Herstellung dieser Bauelemente auf die langfristig stark wachenden Märkte für
 - **Mikrochips** + Maskenreinigung
 - **MEMS** + Advanced Packaging
 - **LED** + 3D Integration

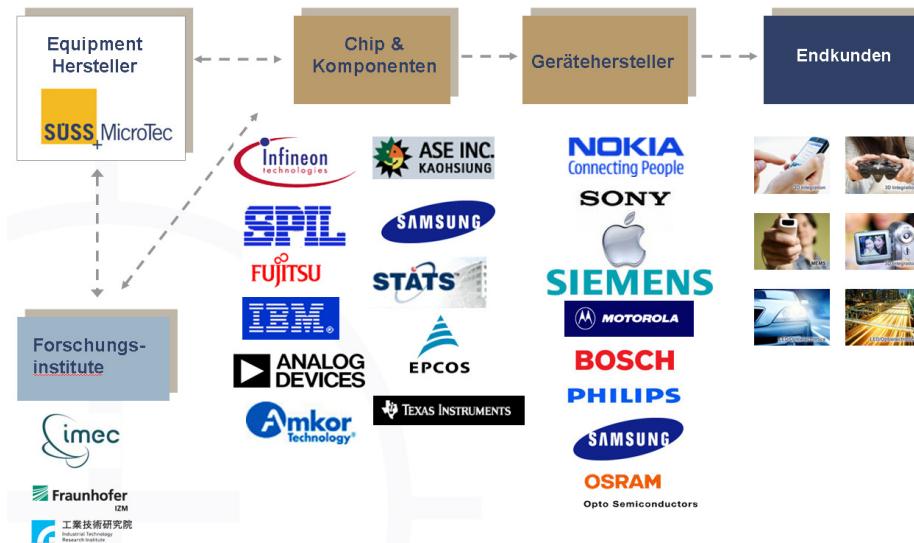


SÜSS MicroTec Produktionssysteme

- + In der Lieferkette für Halbleiter-Produktionssysteme nimmt SÜSS MicroTec eine Schlüsselrolle ein

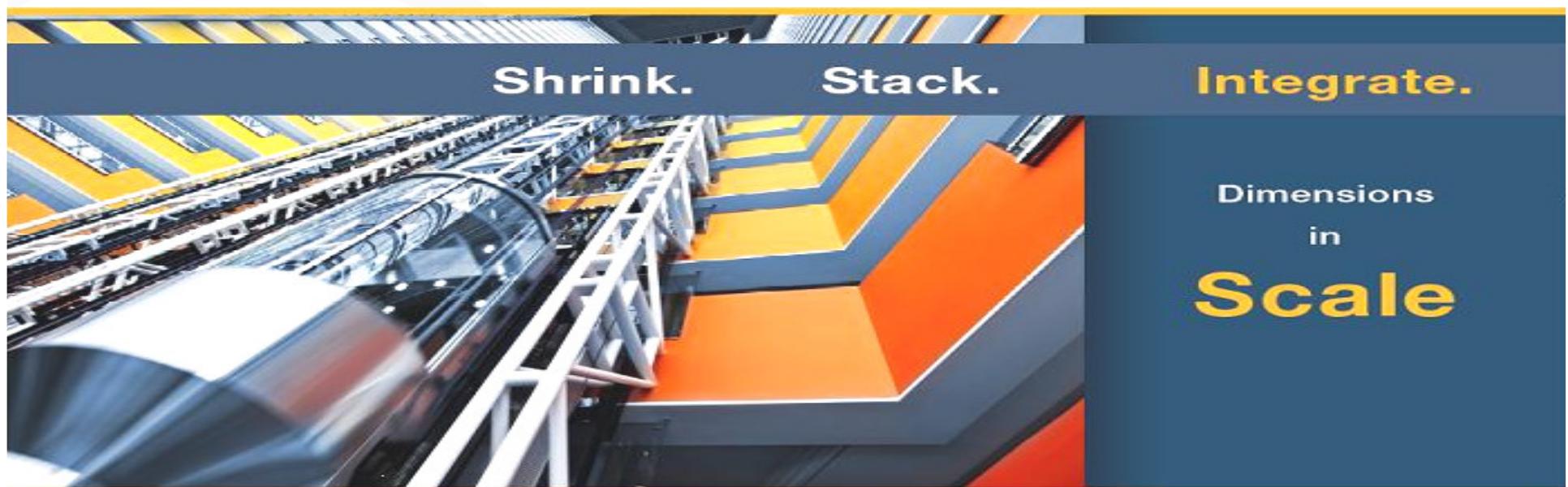
- + Zusammen mit Partnern aus Industrie und Forschung werden hochinnovative Anlagen entwickelt, die fundamentale Probleme der Halbleiterfertigung adressieren

- + Weltweit werden auf SÜSS MicroTec Anlagen die Bauelemente für Handys, PCs, Tablets, Fernseher usw. hergestellt

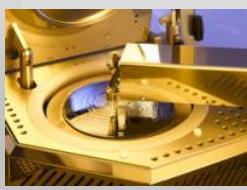


Halbleiter - Trends

- + Die Erhöhung der Komplexität und der Leistungsfähigkeit künftiger Mikrochip Generationen erfordert eine weitere Skalierung der Halbleiterelemente
- + SÜSS MicroTec's ineinandergreifende Produkt- und Prozesslösungen unterstützen sowohl die zweidimensionale Verkleinerungen der Chipstrukturen ("Moore's Law") wie auch den dreidimensionale Aufbau von Chips ("More than Moore")



Innovative Produkte und Prozesslösungen

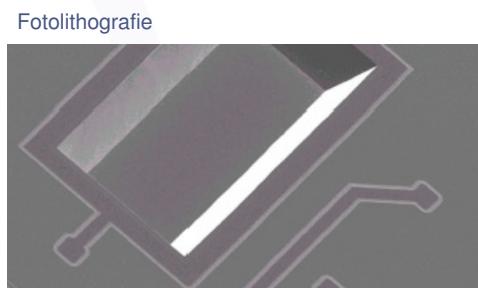
Segmenten	Fotomasken Equipment	Lithografie	Substrat Bonder
Produkte	 Mask Track	 Mask Aligner	 Coater/ Developer
Prozesse	Frontend  Fotomasken- Reinigung	Backend  Justierung Belichtung Nano-Prägung	 Belackung Entwicklung
Kennzahlen 2010	Umsatz: 18,4 Mio. EUR EBIT: 2,1 Mio. EUR	Umsatz: 88,9 Mio. EUR EBIT: 17,0 Mio. EUR	Umsatz: 24,7 Mio. EUR EBIT: -7,1 Mio. EUR

Beispiel: MEMS Fertigung



Optimierung der Ausbeuten durch:

- + Hochleistungs - Belichtungsoptik
- + Kosteneffiziente Verifikation der Positionierung
- + Sprühbelacken und Entwickeln auf Topografien
- + Vollfeld Waferbelichtung in einem Schritt
- + Metall-Bonden unten hohem Druck und hoher Temperatur



Beispiel: 3D-Integration



Coater / Developer



Mask Aligner

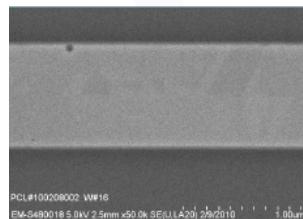


Wafer Bonder

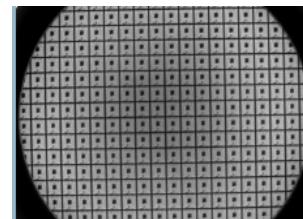
3D-Skalierung:

- + Flexibel einsetzbare Geräte für verschiedene temporäre Bond- und Debond - Prozesse
- + Absolut gleichmäßiger Druck beim Bonden
- + Handhabung von gedünnten Wafern
- + Herstellung von TSVs mit Hilfe von Hochleistungs-Belichtungsoptiken
- + Gleichmäßiges Sprühbelacken auf Topografien

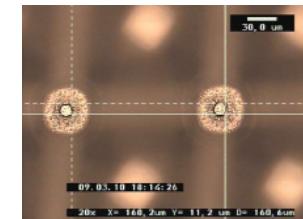
Permanentes Bonden



Temporäres Bonden



3D-Lithografie



Zukunft gestalten

- + SÜSS MicroTec ist ein erfolgreicher „Global Player“ mit:

- Starkem Markennamen
 - + Präzision
 - + Zuverlässigkeit
 - + Langlebigkeit
- Technologischer Innovation
- Abgestimmten Produkt- und Prozesslösungen
- Globaler Präsenz



- + SÜSS MicroTec ist hervorragend aufgestellt, um die zukünftigen Trends der Halbleiterindustrie mit zu gestalten und mit ihnen zu wachsen

Agenda

- I. Überblick
- II. Strategische Restrukturierung
- III. Das Geschäftsjahr 2010 in Zahlen und Q1 2011 in Zahlen
- IV. Die Aktie
- V. Produkte und Märkte
- VI. Ausblick

Ausblick

Erfolge

- + Starke Wettbewerbsposition: Nr. 1 oder 2 in den Zielmärkten
- + Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität durch schlanke Konzernstruktur
- + Ausbau der soliden Finanzsituation

Ausblick

- + Zweistelliges Wachstum in Zielmärkten erwartet
- + Starkes Wachstumspotenzial im Segment Substrat Bonder

Prognose

- + GJ 2011e:
 - Umsatz über 170 Mio. €
 - EBIT- Marge 10% – 15%
- + H1 2011e:
 - Auftragseingang über 80 Mio. €
 - Umsatz über 80 Mio. €



SÜSS₊MicroTec

Vielen Dank !